

BYK-ET 3004

水系および溶剤系電極スラリーの高濃度化、およびセパレーターコーティング用のセラミック材料を分散するための無溶剤型分散剤

製品データ

組成

酸性基を有する共重合体のアルキルアンモニウム塩

一般性状

本データシートに記載した数値は代表値であり、品質規格ではございません。

密度 (20 °C):	1.08 g/ml
不揮発分 (10分, 150 °C):	80 %
アミン価:	94 mg KOH/g
酸価:	94 mg KOH/g
電気化学的安定性:	0.1 V ~4.8 V (vs. Li/Li ⁺)

貯蔵および輸送

分離や濁りが起きる場合があります。30-40°Cに加熱し、よく攪拌してからご使用下さい。

適用分野

エネルギー貯蔵

特長

BYK-ET 3004を正極スラリーに添加すると、立体安定化により粘度が大幅に低下します。これにより、スラリーの流動特性が向上し、固形分を増やすことができます。酸性共重合体は、さまざまな酸化物またはリン酸塩ベースの正極材料に対して高い親和性を示します。同様に、アルミナのようなセラミック材料は、水系および溶剤型のセパレーターコーティングの両方によく分散します。

推奨添加量

配合に対して添加剤として:

正極電極スラリー:	0.2-2 %
セラミック材料:	0.5-2 %

上記推奨添加量は初期値として記載しております。最適添加量はラボ試験を行い決定して下さい。

添加方法

BYK-ET 3004を最初に溶剤とバインダーに添加し、均一に混合する必要があります。粒子サイズと粘度に関する分散品質の測定は分散剤が正しい選択であるかを判断するのに役立ちます。

ビツケミー・ジャパン株式会社
本 社: 東京都新宿区市谷本村町3-29
大 阪: 大阪市北区堂島浜1-4-4
www.byk.com/jp



BYK-Chemie GmbH
P.O. Box 10 02 45
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® and Y 25® are registered trademarks of the BYK group.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.

This issue replaces all previous versions.